

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 24 年 3 月 29 日 (2012.3.29)

【公開番号】特開 2011-190461 (P2011-190461A)

【公開日】平成 23 年 9 月 29 日 (2011.9.29)

【年通号数】公開・登録公報 2011-039

【出願番号】特願 2011-128109 (P2011-128109)

【国際特許分類】

C 0 8 L 67/00 (2006.01)

C 0 8 K 7/00 (2006.01)

H 0 1 R 13/46 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 67/00

C 0 8 K 7/00

H 0 1 R 13/46 3 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 2 月 9 日 (2012.2.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

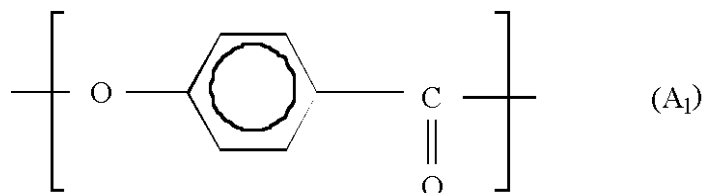
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

液晶ポリエステル樹脂 100 重量部に対し、繊維状無機充填材 10 ~ 100 重量部および板状無機充填材 10 ~ 100 重量部を配合することにより、 1000 sec^{-1} の剪断速度かつ流動温度 + 40 の温度における見かけの熔融粘度が $10 \sim 100 \text{ Pa} \cdot \text{sec}$ である液晶ポリエステル樹脂組成物を製造する方法であって、液晶ポリエステル樹脂が下記式 (A₁) で表される繰り返し構造単位を少なくとも 30 モル% 含み、液晶ポリエステル樹脂の流動温度が 270 ~ 400 であり、繊維状無機充填材の平均繊維径が 0.1 ~ 10 μm かつ数平均繊維長が 1 ~ 100 μm であり、板状無機充填材の平均粒径が 5 ~ 20 μm であり、繊維状無機充填材の配合量 (F) と板状無機充填材の配合量 (P) との比 (F/P) が、 $0 < F/P < 0.5$ または $1.6 < F/P < 10$ であることを特徴とする液晶ポリエステル樹脂組成物の製造方法。

【化 1】



【請求項 2】

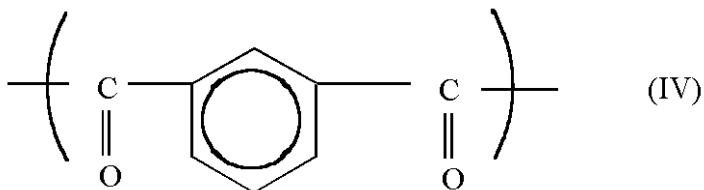
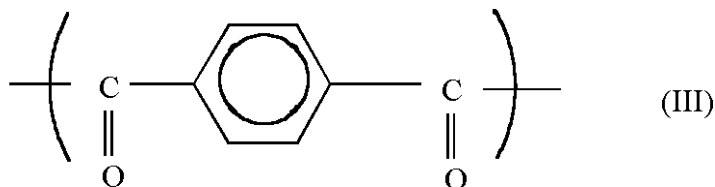
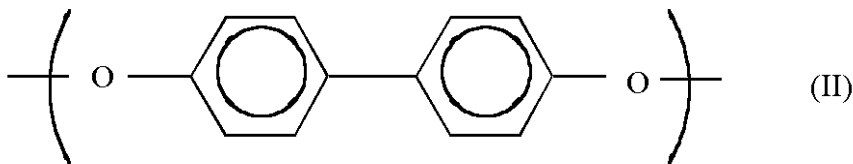
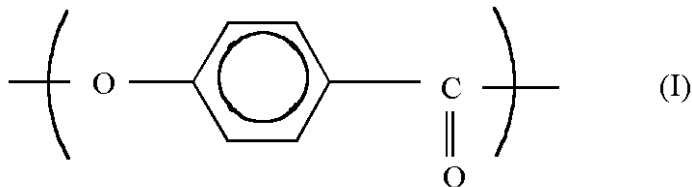
液晶ポリエステル樹脂が、液晶ポリエステル樹脂 (A) 100 重量部および液晶ポリエステル樹脂 (B) 10 ~ 150 重量部からなり、液晶ポリエステル樹脂 (A) の流動温度が 310 ~ 400 であり、液晶ポリエステル樹脂 (B) の流動温度が 270 ~ 370 であり、かつ液晶ポリエステル樹脂 (A) の流動温度は液晶ポリエステル樹脂 (B) の流動温度より高く、その差が 10 ~ 60 であることを特徴とする請求項 1 記載の液晶

ポリエステル樹脂組成物の製造方法。

【請求項 3】

液晶ポリエステル樹脂 (A) および (B) が、それぞれ下記の構造単位 (I)、(II)、(III) および (IV) からなり、それぞれ (II) / (I) のモル比率が 0.2 以上 1.0 以下、(III) + (IV) / (II) のモル比率が 0.9 以上 1.1 以下、(IV) / (III) のモル比率が 0 より大きく 1 以下であって、液晶ポリエステル樹脂 (A) の (IV) / (III) のモル比率 () と、液晶ポリエステル樹脂 (B) の (IV) / (III) のモル比率 () との比である、モル比率 () / モル比率 () が 0.1 以上 0.5 以下であることを特徴とする請求項 2 記載の樹脂組成物の製造方法。

【化 2】



【請求項 4】

繊維状無機充填材が、ガラス繊維、ウォラストナイト、ホウ酸アルミニウムウイスカ、チタン酸カリウムウイスカから選ばれる少なくとも 1 種であることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の液晶ポリエステル樹脂組成物の製造方法。

【請求項 5】

板状無機充填材が、マイカ、タルクから選ばれる少なくとも 1 種であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の液晶ポリエステル樹脂組成物の製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の製造方法により液晶ポリエステル樹脂組成物を得、この液晶ポリエステル樹脂組成物を成形することを特徴とする最小肉厚が 0.2 mm 以下である成形体の製造方法。

【請求項 7】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の製造方法により液晶ポリエステル樹脂組成物を得、この液晶ポリエステル樹脂組成物を成形することを特徴とする最小肉厚が 0.2 mm 以下であるコネクタの製造方法。